



|  |  |
|--|--|
| <b>Title of Change:</b>                          | Qualification of new lead frame with Downset change for NCP3170ADR2G SOIC8.  |
| <b>Proposed First Ship date:</b>                 | 20 Nov 2020 or earlier if approved by customer   |
| <b>Contact Information:</b>                      | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Elmer.Milar@onsemi.com">Elmer.Milar@onsemi.com</a>   |
| <b>PCN Samples Contact:</b>                      | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a><br>Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.<br>Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements. |
| <b>Additional Reliability Data:</b>              | Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Nhel.Malonzo@onsemi.com">Nhel.Malonzo@onsemi.com</a>   |
| <b>Type of Notification:</b>                     | This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change.<br>ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>                       |
| <b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b> | Changed product will be identified by datecode.  |
| <b>Change Category:</b>                          | Assembly Change  |
| <b>Change Sub-Category(s):</b>                   | Material Change  |

**Sites Affected:**

**ON Semiconductor Sites**

ON Semiconductor Carmona, Philippines

**External Foundry/Subcon Sites**

None

**Description and Purpose:**

Change in package leadframe. There is no change in the exterior form, fit or function of the product.

|                   | Before Change Description                 | After Change Description                                 |
|-------------------|---|--|
| <b>Lead Frame</b> | H00976A537<br>with LF DS, 8mils +/-1.5mil | H00976A539 (engineering)<br>New LF with<br>No LF downset |

There is no product marking change as a result of this change.

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME : NCP3170BDR2G

RMS : 63202 and 69234

PACKAGE : SOIC8

| Test  | Specification       | Condition                         | Interval | Results |
|-------|---------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| HTSL  | JESD22-A103         | Ta= 150°C                         | 1008 hrs | 0/239   |
| TC    | JESD22-A104         | Ta= -65°C to +150°C               | 500 cyc  | 0/239   |
| HAST  | JESD22-A110         | 130°C, 85% RH, 18.8psig, bias     | 192 hrs  | 0/240   |
| uHAST | JESD22-A118         | 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased | 96 hrs   | 0/240   |
| PC    | J-STD-020 JESD-A113 | MSL 3 @ 260 °C                    |          | Passed  |



**Electrical Characteristics Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

**List of Affected Parts:**

*Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).*

| Part Number  | Qualification Vehicle |
|--------------|-----------------------|
| NCP3170ADR2G | NCP3170BDR2G          |
| NCP3170BDR2G | NCP3170BDR2G          |

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22980X

発行日: 13 Aug 2020

| 変更件名:                                 | NCP3170ADR2G SOIC8 のダウンセット変更のある新しいリードフレームの認定  |   |  |        |
|---------------------------------------|---|---|--|--------|
| 初回出荷予定日:                              | 20 Nov 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。  |   |  |        |
| 連絡先情報:                                | 現地のオン・セミコンダクター営業所または <a href="mailto:Elmer.Milar@onsemi.com">Elmer.Milar@onsemi.com</a> にお問い合わせください。  |   |  |        |
| サンプル:                                 | 現地のオン・セミコンダクター営業所または <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> にお問い合わせください。<br>サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。<br>サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。                          |   |  |        |
| 追加の信頼性データ:                            | お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <a href="mailto:Nhel.Malonzo@onsemi.com">Nhel.Malonzo@onsemi.com</a> にお問い合わせください。   |   |  |        |
| 通知種別:                                 | これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。<br>オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> 宛てにお願いします。 |   |  |        |
| 変更部品の識別:                              | 変更された製品は、日付コードによって識別されます。   |   |  |        |
| 変更カテゴリ:                               | アセンブリの変更  |   |  |        |
| 変更サブカテゴリ:                             | 材料の変更   |   |  |        |
| 影響を受ける拠点:                             |   |   |  |        |
| オン・セミコンダクター拠点:                        | 外部製造工場 / 下請業者拠点:  |   |  |        |
| ON Semiconductor Carmona, Philippines | 無し  |   |  |        |
| 説明および目的:                              | パッケージリードフレームの変更。製品の外觀形状、適合性、機能に変更はありません。  |   |  |        |
|                                       |   | 変更前の表記                                    | 変更後の表記   |        |
| リードフレーム                               |   | H00976A537<br>with LF DS, 8mils +/-1.5mil | H00976A539 (engineering)<br>New LF with<br>No LF downset |        |
| 今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。             |   |   |  |        |
| 信頼性データの要約:                            |   |   |  |        |
| デバイス名:                                | NCP3170BDR2G  |   |  |        |
| RMS:                                  | 63202 and 69234   |   |  |        |
| パッケージ:                                | SOIC8   |   |  |        |
| テスト                                   | 仕様  | 条件  | 間隔   | 結果     |
| HTSL                                  | JESD22-A103   | Ta= 150°C                                 | 1008 hrs   | 0/239  |
| TC                                    | JESD22-A104   | Ta= -65°C to +150°C                       | 500 cyc  | 0/239  |
| HAST                                  | JESD22-A110   | 130°C, 85% RH, 18.8psig, bias             | 192 hrs  | 0/240  |
| uHAST                                 | JESD22-A118   | 130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased         | 96 hrs   | 0/240  |
| PC                                    | J-STD-020 JESD-A113   | MSL 3 @ 260 °C                            |  | Passed |

**最終製品 / プロセス変更通知**

文書番号# : FPCN22980X

発行日: 13 Aug 2020

**電気的特性の要約:**

電気的特性への影響はありません。

**影響を受ける部品の一覧:**

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

| 部品番号         | 認定試験用ピークル    |
|--------------|--------------|
| NCP3170ADR2G | NCP3170BDR2G |
| NCP3170BDR2G | NCP3170BDR2G |



---

## Appendix A: Changed Products

---

D

---

| Product      | Customer Part Number | Qualification Vehicle | New Part Number | Replacement Supplier |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| NCP3170ADR2G |                      | NCP3170BDR2G          |                 |                      |
| NCP3170BDR2G |                      | NCP3170BDR2G          |                 |                      |